

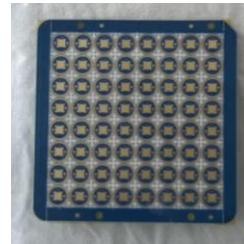
■メタライズ

★特徴

シリコンやSiC素子との熱膨張差を小さく抑え、

長期安定動作

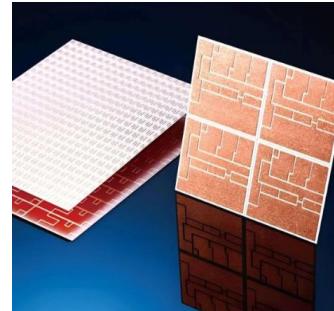
に寄与



メタライズ層にはMo/Mn + Ni/Au、またはW + Ni/Auなどの多層構造が一般的に採用され、ハンダ付け性・ワイヤボンディング性に優れています。

★主な用途

- ・パワーモジュール基板
(IGBT、SiC、GaN用)
- ・LED、LD放熱基板
- ・高周波部品の実装基板
- ・センサーの放熱部材



■構造部品

★特徴

前述製品の特長である

高放熱:高絶縁:高強度

を兼ね備え、金属代替材として採用が拡大



高温環境下で使用される精密機構部品として用途に合わせた整形を行います。

★主な用途

- ・半導体装置の治具、サセプタ、スペーサー
- ・光学系、レーザー機器の放熱部材
- ・高温環境下の絶縁支持体、機構部品
- ・真空装置、高周波装置用の断熱、放熱構造材